

2026年1月発表
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2025年度～2027年度)

2026年1月15日

SEAJ

一般社団法人日本半導体製造装置協会

予測の概要

この予測は、半導体製造装置及び FPD 製造装置の需要動向に関して、一般社団法人日本半導体製造装置協会(略称 SEAJ、会長 河合 利樹)の半導体調査統計専門委員会及び FPD 調査統計専門委員会による需要予測と SEAJ 理事・監事会社 20 社による市場規模動向調査結果を総合的に議論・判断し、SEAJ の総意としてまとめた結果である。

半導体製造装置について、2025 年度の日本製装置販売高は、台湾ファウンドリーの 2nm (GAA) 投資の本格化、HBM を中心とした DRAM 投資の底堅さにより前年度比 3%増の 4 兆 9,111 億円と予測した。2026 年度は DRAM 投資拡大の継続に加え、AI サーバー向け先端ロジック投資拡大が期待されることから、12%増の 5 兆 5,004 億円とした。2027 年度も AI 関連の需要が高水準で続くため、2%増の 5 兆 6,104 億円と予測した。

FPD 製造装置については、2025 年度は韓国と中国で G8.6 クラスの基板を使った OLED 投資が開始されたが、3 月までの販売計上タイミングを精査した結果、3%増の 3,490 億円と予測した。2026 年度も G8.6 基板 OLED 投資は行われるが、一部は翌年度に繰り越されるため横ばいの 3,490 億円と予測した。2027 年度は OLED の前年度繰り越し分と、TV 画面サイズの大型化による投資を合わせ、23%増の 4,292 億円と予測した。

(1)予測期間 2025年度～2027年度の3年間 (2025年度:2025年4月より2026年3月まで)

(2)予測項目 半導体製造装置の「日本製装置」及び「日本市場」販売高
FPD製造装置の「日本製装置」販売高

(3)予測の背景

(半導体産業)

昨年 12 月の WSTS(世界半導体市場統計) の発表によれば、2025 年の世界半導体市場は、大手 IT 企業等によるデータセンター投資が牽引し、メモリー製品およびロジック製品の高成長により、前年比 22.5%増の 7,722 億ドルと 2 年連続で過去最高を更新する見込みである。2026 年も引き続きデータセンター投資が牽引役となり、メモリー製品とロジック製品の高成長が期待されることから、前年比 26.3%増の 9,755 億ドルと予想され、1 兆ドルの大台が目前に迫る。

メモリー各社の業績は 2023 年 1Q(1～3 月)に底を打って以降、総じて上昇基調を続け、営業利益率は高水準にある。DRAM については 2025 年後半から HBM に加え、AI サーバー向けの汎用 DRAM 需要も急増し、供給が大幅に逼迫しているが、建屋・ユーティリティそのものが不足しており、装置の購入・立ち上げを含めた生産能力構築が、当面の AI 需要に追い付かない状態となりつつある。

NAND については AI データセンター向け需要拡大に加え、HDD の供給不足も重なり、データセンター向け SSD の需要が急増している。需要の継続性に対する不透明感や高利益率の DRAM への投資優先により、現段階では大規模な投資拡大は見られないものの、ASP は上昇基調にあり、今後の収益性改善に伴う投資加速が期待される。

ロジックに関しては、データセンター向けの AI チップは汎用的な GPU に加え、特定用途に特化した低いコストで高速処理・低消費電力を実現する ASIC の需要が拡大している。スマートフォンや PC 向けの Logic についてもエッジ側で消費電力を抑えながら高速な AI 処理を実行するため、今後もさらなる微細化とヘテロジニアスインテグレーションが求められる。

将来的にも AI が半導体市場の成長を牽引する。現在の「LLM」(大規模言語モデル)を基盤として、計画立案・意志決定・行動が可能な「Agentic AI」や、現実世界を認識・理解して物理的な空間で行動する「Physical AI」へと発展していくとみられており、より高度なモデルの学習と、その推論の実行にはさらに多くのコンピューティングパワーが必要となる。これに伴い、半導体の高性能化・低消費電力化・大容量化の要求は一段と高まり、GAA 構造の更なる進化、HBM をはじめとするメモリーの高積層化、BSPDN (Back Side Power Delivery Network)の採用など、技術進化に伴う先端投資が期待される。

特にロジックの性能向上に対してメモリー帯域幅の向上がボトルネックとなる、いわゆる「メモリーウォール」の問題解決に向け、DRAM の微細化や積層数増加による HBM の容量拡大と世代移行の加速、さらに大容量な NAND を用いた HBF(High Bandwidth Flash)など、新たなメモリー技術の登場も期待される。

当初、世界半導体市場は 2024 年の 6,305 億ドルから 2030 年に 1 兆ドルへ到達すると予想されていたが、1 兆ドル到達の時期は従来の想定より大幅な前倒しとなる可能性が高まっている。半導体製造装置も同様に、中期的に高い成長が見込まれる。

(FPD 産業)

FPD製造装置を取り巻く環境として、ディスプレイ製造メーカーの業績は2023年Q2(4~6月)頃から業績改善傾向にあるが、韓国企業2社を除くと利益水準は高くない。2025年のTV用のLCDパネル出荷は数量で微減となるものの、平均サイズの大型化により出荷額と面積は上昇する見込みである。

平均サイズの大型化は、特に中国で顕著となってきており、中期的には現在の主流である65型から、75型・85型へのシフトも進むと考えられる。

韓国と中国においては、既にG8.6基板を用いたIT用OLEDパネル製造のための設備投資が始まっている。今後はタブレット(11.1・13型等)への採用から、順次ノートPC(13.6・14.2・15.3・16.2型等)へのOLEDパネル採用が進んでいく。

ただし直近の状況としては、AI機能強化の優先度やメモリーコストの高騰もあって、IT製品へのOLEDパネル搭載については全体として当初の計画からは若干後ろ倒しになっている。いずれにせよ、スマートフォン(6.1~6.9型)と比較し、IT用パネルは1台当たりの面積が6~7倍以上と大きくなる。OLEDの搭載が進んでくれば装置需要としても成長が期待される見方に変化はない。

日本製FPD製造装置販売高は、2025年度から2026年度は微増から横ばいで推移したのち、2027年度から本格的に回復する見通しとなっている。

(4)予測結果

【半導体／FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2025年度は、半導体製造装置が3%増、FPD製造装置が3%増、全体で3%増の5兆2,601億円と予測した。2026年度は、半導体が12%増となるがFPDは横ばいの±0%とみており、全体で11.2%増の5兆8,494億円とした。2027年度は、半導体2%増、FPD23%増を見込んでおり、全体では3.3%増の6兆397億円と予測した。

【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】

2025年度は一部のロジックや車載、パワー半導体への投資の停滞は続くものの、台湾ファウンドリーの2nm投資の本格化、HBMを中心としたDRAM投資の底堅さにより前年度比3%増の4兆9,111億円を予測した。前年比の伸び率としては、2024年度実績が「29%増」にまで上振れて着地したこともあり、成長率は低いが高水準の販売額が続く。

2026年度はDRAM投資拡大の継続に加え、AIサーバー向け先端ロジック投資拡大が期待されることから、12%増の5兆5,004億円とした。2027年度もAI関連の需要は高水準で続くため、2%増の5兆6,104億円と予測した。

2025年度、2026年度、2027年度のすべての年度で、昨年7月発表の予測金額から上方修正となった。

【半導体製造装置・日本市場販売高予測】

2025年度は車載とパワー半導体の投資が大きく落ち込んだ。NANDフラッシュとDRAMの先端投資が行われたものの、全体としては緩やかな伸びにとどまるため、5%増の1兆3,147億円と予想した。

2026年度も堅調なメモリー投資が予想され、5%増の1兆3,805億円と予測した。

2027年度は更に大手ファウンドリーの第二期投資や2nmロジックの量産投資も加わるため、10%増の1兆5,185億円を予測した。

【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2025年度はG8.6基板を用いたIT用OLED投資が始まったことから、3%増の3,490億円を予想した。2026年度はTVパネル平均サイズの大型化を背景としたLCDの投資が見込まれる一方、G8.6 OLED投資が想定より緩やかなペースとなったため、横ばいの3,490億円とした。

2027年度は2026年度の繰り越し分を含めた複数のG8.6クラスのOLED投資が期待され、TV用パネルの平均サイズ大型化を背景としたLCD投資も加わるため、23%増の4,292億円を予測した。

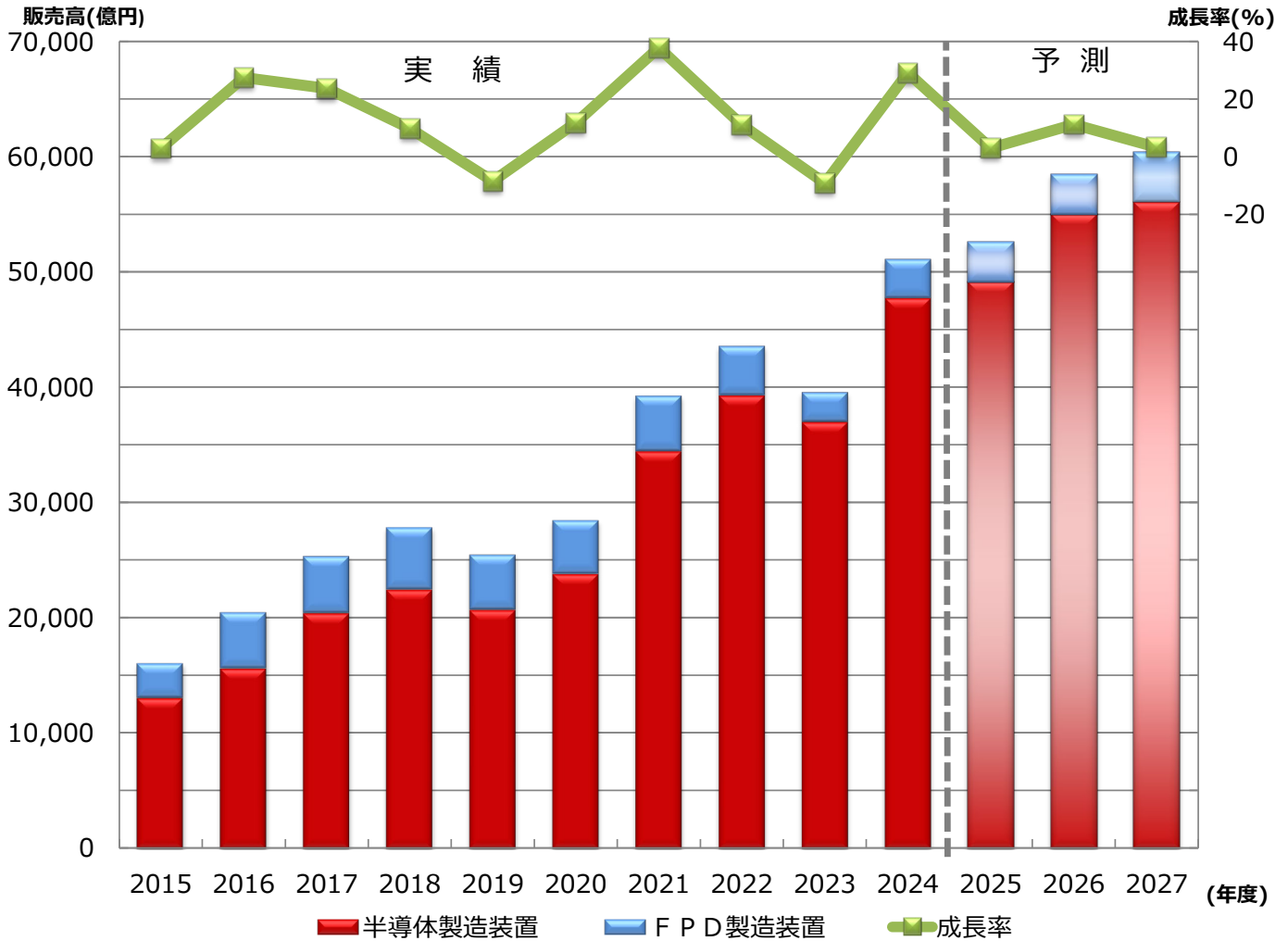
-以上-

2026年1月 半導体及びFPD製造装置 需要予測

■ 1. 半導体及びFPD製造装置 全装置予測

【日本製装置販売高予測】

*「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



(CAGR : 2024年度 – 2027年度)

年度	実績										予測			CAGR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
半導体製造装置	13,089	15,642	20,436	22,479	20,730	23,835	34,430	39,275	36,976	47,681	49,111	55,004	56,104	5.8%
FPD製造装置	2,993	4,857	4,916	5,364	4,758	4,638	4,809	4,282	2,577	3,388	3,490	3,490	4,292	
合計(億円)	16,082	20,499	25,352	27,843	25,488	28,473	39,239	43,556	39,553	51,069	52,601	58,494	60,397	
前年比成長率(%)	2.8	27.5	23.7	9.8	-8.5	11.7	37.8	11.0	-9.2	29.1	3.0	11.2	3.3	

* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複製すること、公表または公表を補助することを禁止します。

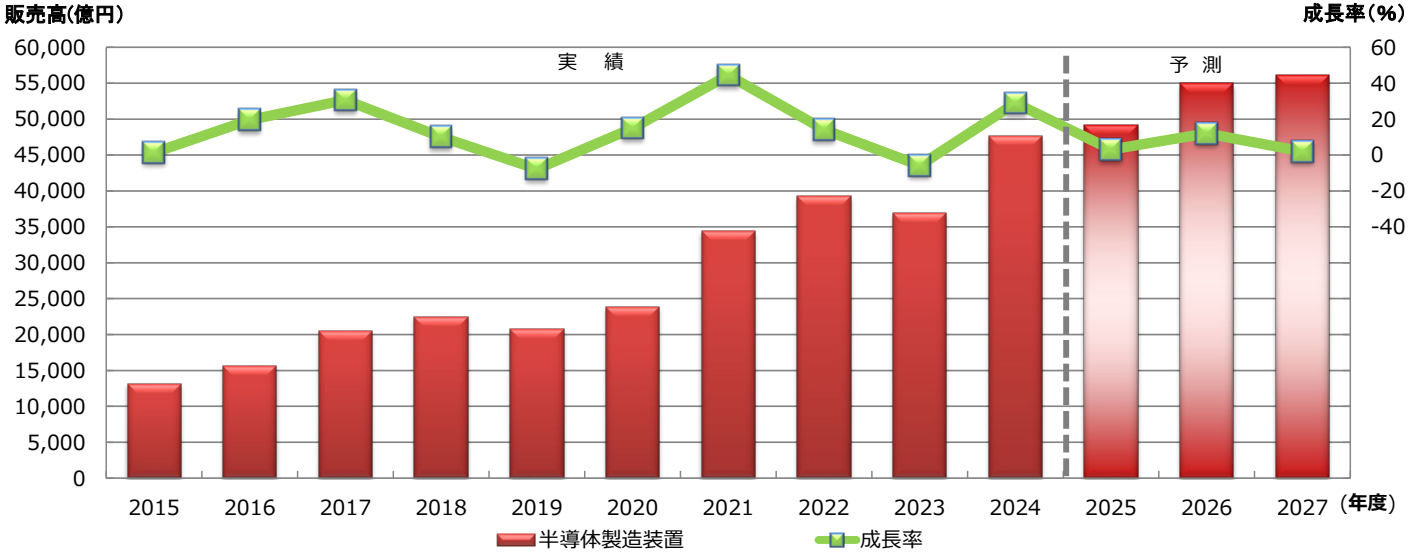
* 2019年度はFPDの統計参加企業に変動がありました。統計参加企業の変更対象社名と金額は非公表です。

2026年1月 半導体及びFPD製造装置 需要予測

■ 2. 半導体製造装置

【日本製装置販売高予測】

*「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。

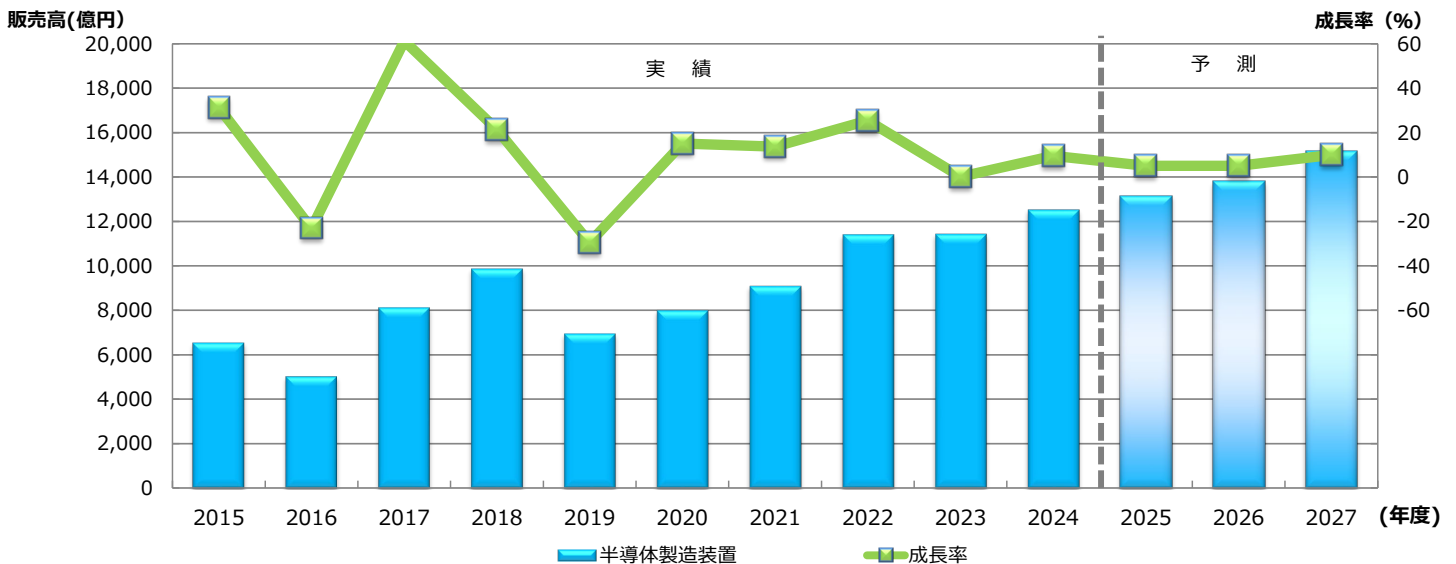


(CAGR : 2024年度 - 2027年度)

年度	実績										予測			CAGR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
合計(億円)	13,089	15,642	20,436	22,479	20,730	23,835	34,430	39,275	36,976	47,681	49,111	55,004	56,104	
前年比成長率(%)	1.3	19.5	30.6	10.0	-7.8	15.0	44.4	14.1	-5.9	29.0	3.0	12.0	2.0	5.6%

【日本市場販売高予測】

*「日本市場販売高」とは、国内向日系企業及び国内向外国系企業製装置の販売高です。



(CAGR : 2024年度 - 2027年度)

年度	実績										予測			CAGR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
合計(億円)	6,562	5,047	8,138	9,878	6,961	8,009	9,103	11,412	11,432	12,521	13,147	13,805	15,185	
前年比成長率(%)	31.2	-23.1	61.3	21.4	-29.5	15.1	13.7	25.4	0.2	9.5	5.0	5.0	10.0	6.6%

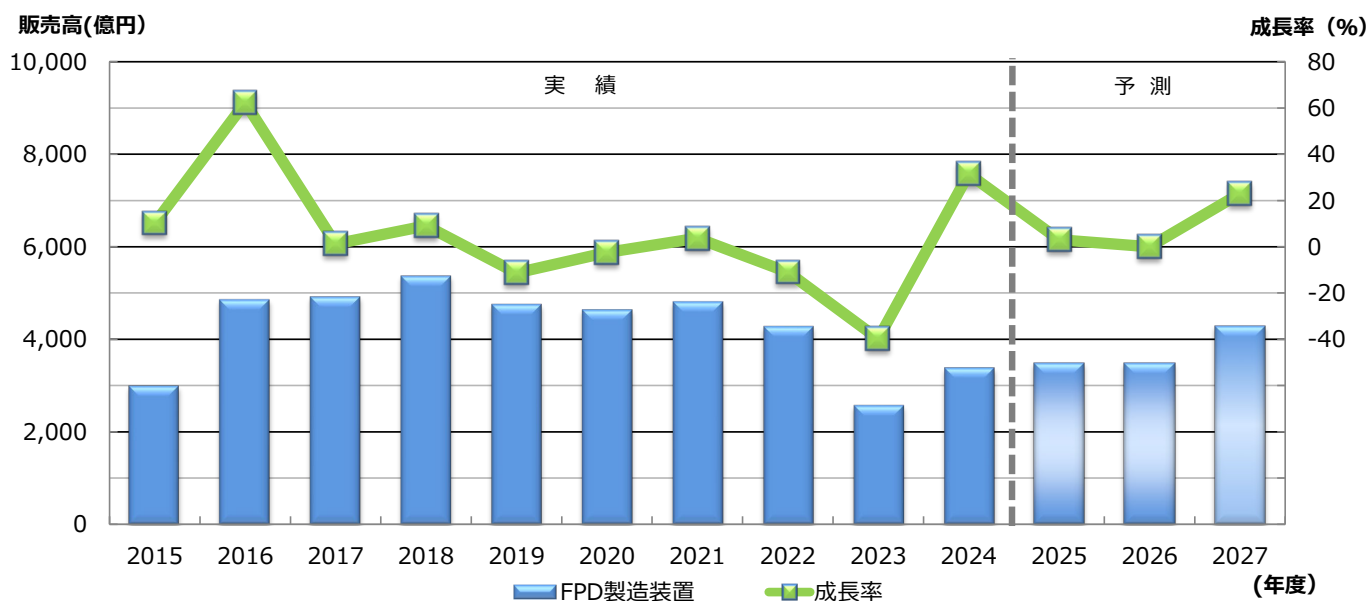
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複製すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2026年1月 半導体及びFPD製造装置 需要予測

■ 3. FPD製造装置

【日本製装置販売高予測】

*「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



(CAGR：2024年度－2027年度)

年度	実績										予測			CAGR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
合計(億円)	2,993	4,857	4,916	5,364	4,758	4,638	4,809	4,282	2,577	3,388	3,490	3,490	4,292	
前年比成長率(%)	10.2	62.3	1.2	9.1	-11.3	-2.5	3.7	-11.0	-39.8	31.4	3.0	0.0	23.0	8.2%

* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

* 2019年度はFPDの統計参加企業に変動がありました。統計参加企業の変更対象社名と金額は非公表です。